

## 反応性イオンエッティングによる磁性酸化物微細構造の創製

Fabrication of magnetic oxides microstructures by reactive ion etching

研究代表者 東京工業大学大学院総合理工学研究科 助手 谷山 智康

Department of Innovative and Engineered Materials,  
Tokyo Institute of Technology, Tomoyasu TANIYAMA

Remarkable chemical enhancement in etch rate of La-manganite thin film is obtained in CO/NH<sub>3</sub> reactive ion etching. The etch rate of 70 nm/min and the selectivity of 4.7 for LSMO thin films over Ti mask are achieved. The edge morphology of the patterned La-manganite becomes significantly smooth compared with pure Ar ion milling. A possible plasma chemistry is also proposed.

### 1. 研究目的

マンガン酸化物は100%を超える極めて大きな巨大磁気抵抗効果を示すことから、次世代型磁気抵抗ヘッド材料の一つとして考えられている。マンガン酸化物を磁気抵抗ヘッドとして利用するためには、いくつかの困難を克服する必要がある。低磁場における磁気抵抗を増大させる手法の確立や効率的な微細加工技術の開発がそれにあたる。特に微細加工技術の開発は磁気抵抗ヘッドを作製するための中核をなす技術であり重要である。

マンガン酸化物の微細加工技術を開発するためには、マンガン酸化物固有の磁気・伝導特性を理解することが必要となる。従来の研究により明らかにされているように、マンガン酸化物の磁気・伝導特性はその微細構造に極めて敏感であり、結晶粒界の存在や結晶性の相違により大きく変化する。そのため、微細加工技術として加工時に極力損傷を与えない手法を選択する必要がある。酸化物に対して現在主として用いられている微細加工技術はイオンミリング法であるが、この手法は試料に大きな欠陥や損傷を与えるため構造敏感な物質に対しては不適当である。

そこで本研究では、比較的試料に損傷を与えない反応性イオンエッティング法（RIE）に着目し、マンガン酸化物に対するエッティング手法の開発を行った。

### 2. 研究経過

#### 2. 1. 実験方法

マンガン酸化物としてLa<sub>0.7</sub>Sr<sub>0.3</sub>MnO<sub>3</sub> (LSMO) を用いた。膜厚200nmのLSMO薄膜をrfスパッタリング法によりSrTiO<sub>3</sub>基板上に700°Cで成膜した。スパッタリングは混合比3:7のAr/O<sub>2</sub>の混合ガス中で

行い、rf電力は2.5W/cm<sup>2</sup>であった。さらに、作製したLSMO薄膜に5μm×5μmのAlおよびTi矩形マスクを電子線リソグラフィ、真空蒸着（真空度は2.0×10<sup>-6</sup>Torr以下）およびリフトオフ法により形成した。

初めに従来のArイオンミリング法により、マスク材料であるAl, Ti, およびLSMO薄膜の微細加工を行い、反応性イオンエッティングとの参照データの収集を行った。次にLSMO薄膜を反応性イオンエッティングにより微細加工した。反応性イオンエッティングには、遷移金属の微細加工に対して有効であることが知られているNH<sub>3</sub>とCOの混合ガスを用いた。反応性イオンエッティングは、反応ガスの流量を10sccmに固定し、NH<sub>3</sub>とCOの混合比を種々に変化させて行い、エッティングレートの最適化を行った。加工したLSMO矩形パターンの形状を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察し、エッティングレートを触針式段差計(Dektak III)により決定した。

#### 2. 2. 実験結果

Figure 1にArイオンミリング法により得られたエッティング時間とエッティング膜厚との関係を示す。エッティングする対象物質に依存せずエッティングレートはほとんど変化せず～16nm/minであった。この結果は、Arイオンミリング法でLSMO薄膜を微細加工するためには、LSMO薄膜と同程度以上の膜厚を持つマスク材料が必要であることを示している。

Arイオンミリング法によりAlおよびTiをマスク材料として用いて微細加工した矩形LSMOのSEM写真をFigure 2に示す。AlをマスクとしたときはLSMOの表面にAlマスクが部分的に残り、エッジ付近の形状が乱れているのがわかる。一方、TiをマスクとしたときにはAlのときを見られたようなマスク材料の残害は見られず、エッジもよりシャープに

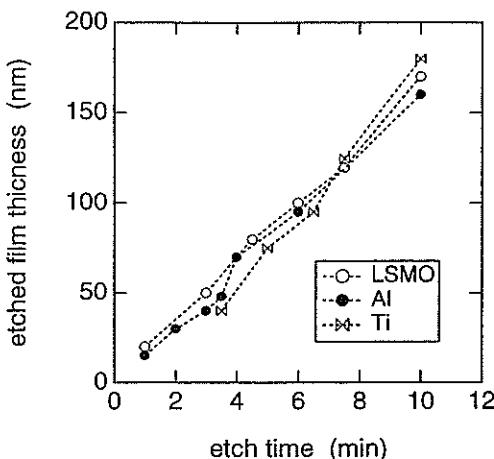


Figure 1 Etch time dependence of removed thickness of LSMO film, Al and Ti masks by Ar ion milling.

なっている。AlとTiとではグレインサイズがそれぞれ800nm, 50nmであることが原子間力顕微鏡(AFM)観察からわかつており、このグレインサイズの相違がエッジ付近の形状の変化に大きく関係しているものと考えられる。以上の結果より、マスク材料としてはAlよりTiの方が適していると考え、以下の反応性イオンエッティングではTiをマスク材料として用いた。

次にLSMO薄膜を反応性イオンエッティングで微細加工したとき結果を示す。Figure 3は種々の混合比を持つNH<sub>3</sub>とCO混合ガス下でエッティングしたときのエッティングレートを示している。Tiに対するエッティングレートがガスの混合比に鍾感であるのに対して、LSMOに対するエッティングレートは混合比に大きく依存し、NH<sub>3</sub>とCOの混合比が1:1のときに70nm/minに達した。このエッティングレートはTiに対するエッティングレートの4.7倍であり、LSMOとTiとで大きな選択性が得られたことを意味している。また、LSMOに対するエッティングレートは、従来の磁性金属に対するエッティングレートと同程度の大きさであることが明らかになった。

Figure 4に反応性イオンエッティングにより微細加工したLSMO薄膜のSEM写真を示す。反応性イオンエッティングにより得られたLSMO矩形パターンのエッジ形状は、Arイオンミリングにより得られたものと比較して極めて滑らかであり、NH<sub>3</sub>とCOの混合ガスを用いた反応性イオンエッティングがLSMOの微細加工に対して有効であることを示している。また、AFM観察の結果、5×5μm<sup>2</sup>のLSMO矩形パターンの表面ラフネスは～0.5 nmであることがわかつ

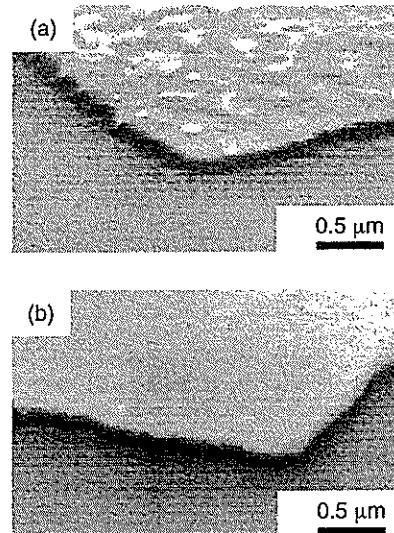


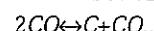
Figure 2 SEM images of the patterned LSMO by Ar ion milling using (a) Al and (b) Ti masks.

た。この表面ラフネスをさらに減少させるためには、微細加工後のO<sub>2</sub>雰囲気中のアニール処理が有效であると考えられる。

### 2. 3. 検討

以上の結果のようにNH<sub>3</sub>とCOの混合ガスを用いた反応性イオンエッティングはLSMO薄膜の微細加工に対して有効であることが明らかとなった。これまでにNH<sub>3</sub>とCOの混合ガスを用いた反応性イオンエッティングは、CoCrやNiFeのような磁性金属に対して用いられてきた。この場合の磁性金属に対するエッティング過程は以下のように理解されている。まずCOプラズマ下において、磁性金属は以下の反応式により低融点もしくは揮発性を示す金属カルボニルを形成する。

$Me + nCO \rightarrow Me(CO)_n$  (Me:遷移金属),  
COガスは自発的にCO<sub>2</sub>に分解するため、COガスのみの場合にはCOガス不足が生じるが、NH<sub>3</sub>ガスの添加により、CO<sub>2</sub>をCOに戻す逆反応が促進する。



そのため、NH<sub>3</sub>とCOの混合ガス下では効率的な金属カルボニル形成がなされ、エッティングがより効率的に進行すると考えられている。

本研究の対象であるマンガン酸化物に対しても、同様のプラズマ反応が生じると考えられる。しかし、LSMOにおいてはLa, Sr, Mnなどの多元素が含まれており、さらに化学的に安定な酸化物であるため、プラズマ反応はより複雑になる。ここで、本研

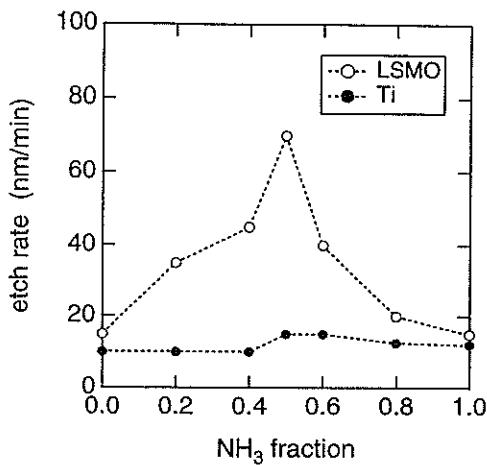


Figure 3 Etch rates of LSMO film and Ti mask by CO/ $\text{NH}_3$  RIE as a function of  $\text{NH}_3$  fraction.

究で得られた大きなエッティングレートを説明する一つの可能性を提案する。上記のように遷移金属の場合、 $\text{NH}_3$ ガスはCOガスの減少を抑制する作用を示したが、遷移金属酸化物では $\text{NH}_3$ ガスがさらに遷移金属酸化物を還元する作用をすることが予想される。もし、これにより酸化物が還元され、引き続きCOによる金属カルボニルの形成がなされれば、遷移金属の場合と同様にエッティングレートの増大が期待されると考えられる。つまり、LSMO薄膜の場合には $\text{NH}_3$ ガスによる還元反応とCOによる金属カルボニル形成の2段階の連続的な反応がエッティングレートの増大に大きな役割を担っていると考えられる。

マンガン酸化物のエッティングの研究として、Wangらは $\text{La}_{1-x}\text{Ca}_x\text{MnO}_3$ を電子サイクロトロン共鳴

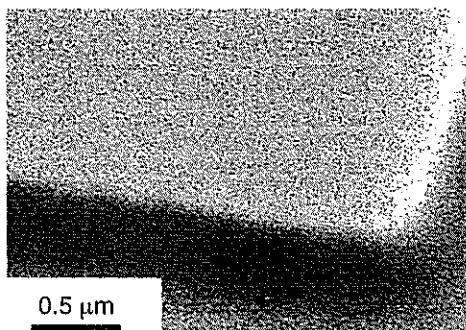


Figure 4 SEM image of the patterned LSMO by CO/ $\text{NH}_3$  RIE.

の条件下で $\text{SF}_6/\text{Ar}$ ,  $\text{Cl}_2/\text{Ar}$ ,  $\text{CH}_4/\text{H}_2/\text{Ar}$ などの混合ガス下でエッティングした結果、Arイオンミリングと比較して優位な結果は得られなかったことを報告している。この結果は、エッティング時に形成される塩化物やフッ化物がカルボニルと比較して大きな融点を持つことに起因していると考えられる。このように、本研究において提案する反応性イオンエッティング時のプラズマ反応過程は従来の研究結果とも矛盾せず最もらしいものであると考えられる。

#### 2. 4.まとめ

$\text{NH}_3$ とCOの混合ガスを用いた反応性イオンエッティングにより、LSMO薄膜に対して70 nm/minにおよぶ大きなエッティングレートが得られ、またTiと比較して4.7倍の選択比が得られた。このエッティングレートの向上は $\text{NH}_3$ ガスによるLSMOの還元とCOによる金属カルボニルの形成に起因していると考えられる。

### 3. 研究成果

$\text{NH}_3$ とCOの混合ガスがマンガン酸化物のエッティングに有効であることが明らかにした。さらに、エッティングレートの向上に寄与したプラズマ反応プロセスを提案した。

### 4. 今後の課題と発展

本研究では、LSMOに対する反応性イオンエッティングにおけるプラズマ反応プロセスを提案したが、実際に膜表面に金属カルボニルが形成されてエッティングレートが増大したかどうかに対する直接的な証拠が得られていない。それを明らかにするためにAuger電子分光や光電子分光によるより詳細な調査を検討している。また、LSMOを磁気抵抗デバイスとして用いるためには、 $\text{NH}_3$ とCOの混合ガスを用いた反応性イオンエッティングにより微細加工し、磁気・伝導特性を詳細に評価する必要があり、早急な対応が迫られている。これらを克服することにより、マンガン酸化物が次世代磁気抵抗ヘッド材料として利用されることを期待したい。

### 5. 発表論文リスト

1. Microfabrication of LSMO wires by dry etching processes: M. Naoe, K. Hamaya, N. Fujiwara, T. Taniyama, Y. Kitamoto, Y. Yamazaki, Digests of PMRC 2000, 115-116 (2000).
2. Selective dry etching of manganite thin films for high sensitive magnetoresistive sensors: M. Naoe, K. Hamaya, N. Fujiwara, T. Taniyama, Y. Kitamoto, Y. Yamazaki, J. Magn. Magn. Mater. (印刷中) .